



2026 年 7 月 17 日

各 位

会 社 名 岡本硝子株式会社
代表者名 代表取締役会長兼 CEO 岡本 毅
(コード番号 7746 東証スタンダード)
問合せ先 財務経理部長 風間 卓
電 話 04-7137-3111

熱伝導率 $200\text{W/m} \cdot \text{K}$ の窒化アルミニウム放熱基板量産認定完了のお知らせ

株式会社 U-MAP (愛知県名古屋市) と協業を進めております窒化アルミニウム放熱基板につき、熱伝導率 $200\text{W/m} \cdot \text{K}$ 製品について国内半導体基板メーカーの量産認定が完了し、初回出荷いたします事をお知らせいたします。

記

量産認定された製品は、 $200\text{W/m} \cdot \text{K}$ と高熱伝導率を有する基板であり、主にデータセンターで使用されるレーザーダイオード(LD)のサブマウント基板として使用されます。データセンターでは膨大なデータ処理に伴うサーバーの発熱が深刻な課題となっております。この課題を解決するため、電気信号を光に置き換える光通信(光電融合技術)の導入が進んでおりますが、発熱源ともなる LD を安定動作させるためレーザーサブマウント(放熱基板)の重要性が急速に高まっております。

今回認定されました製品は $200\text{W/m} \cdot \text{K}$ の熱伝導率を有するセラミックス基板ですが、今後、市場拡大が急速に進んでおりますデータセンター向け LD サブマウント用として、更に熱伝導率を向上させた $230\text{W/m} \cdot \text{K}$ 製品や 0.1mm 超薄放熱基板の開発を進め、当社製品により世の中の熱課題を解決できるよう努めてまいります。

なお、上記の事態に対処する更なる発熱対策品として、 $230\text{W/m} \cdot \text{K}$ 製品及び 0.1mm 超薄基板の試作品提供を開始しており、お客様において初期製品評価が進んでおります。

以上